

アジア半導体関連 フォーカスファンド

愛称：ライジング・セミコン・アジア

追加型投信／内外／株式

NISA
対象

成長投資枠

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は

岡三証券

商号等：岡三証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定・運用は

SBI 岡三アセットマネジメント

商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

投資対象の外国投資信託の運用は

NEUBERGER BERMAN

革新 の 核心



スマートフォンやAI、自動運転などの最先端技術の心臓部を担い、
現代テクノロジー社会において「戦略物資」と呼ばれる半導体。
世界各国がイノベーションを競うなか、
その核心でアジア企業が未来を創る。

当ファンドでは、革新の核心的な役割を担う
アジアの半導体関連企業の株式等に投資を行います。

半導体の進化が世界を変え続ける

現在では当たり前のように利用されているスマートフォンやパソコンなどは、高度な半導体技術によって製造が可能になりました。

半導体の微細化技術によって電子機器や産業機器などの高性能化や省電力化が進み、今後も私たちの生活を豊かにしていくことが期待されています。

半導体の線幅の微細化比較

20年前

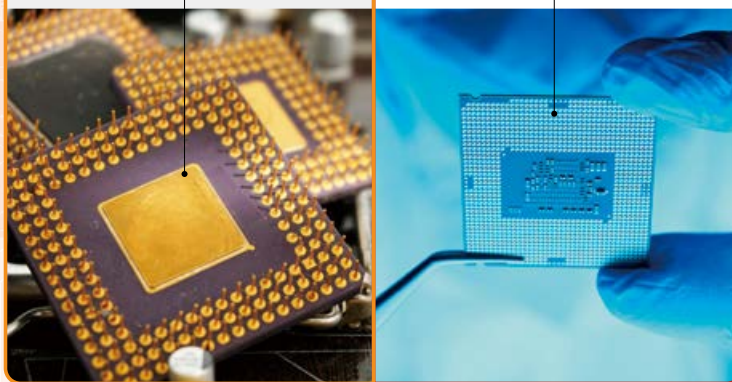
130nm

現在

3nm

約43分の1

nm(ナノメートル)は
10億分の1メートルに相当
<サイズ例>
ウィルス=100nm



※半導体の線幅とは、半導体チップに描かれる電子回路の幅
※上図線幅の大きさはイメージであり、実際とは異なります。

※写真はイメージです。

(出所) 各種資料、報道等

アジアの成長がけん引する半導体市場

国・地域別の半導体市場規模の推移(予想)と成長分野の例

※アジア：日本、アジア太平洋(中国含む)

※2025年以降は、ニューバーガー・バーマンによる2025年2月末時点の予想値(1米ドル=150.63円で円換算)

(出所) ニューバーガー・バーマン、経済産業省、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

200 (兆円)



150

100

50

0



PC

2000年

2005年

2010年

2015年

2020年

2025年予想

2030年予想

190兆円超
2035年予想

データセンター



5Gインフラ



AI



スマートシティ



IoT



電気自動車



自動運転車



スマートフォン

市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

半導体市場を支えるアジア

半導体の製造工程とアジアの重要性

半導体ができるまで、「設計」、「製造」、「組立」と大きく3つの工程に分かれます。

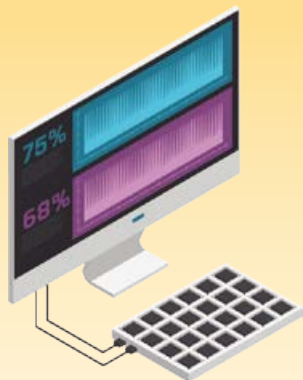
特に「製造」と「組立」では近年技術革新が起こっており、半導体の需要拡大に伴い高い成長が期待されています。

その「製造」と「組立」で高いシェアを占めるアジアは、半導体の供給や進化において非常に重要な役割を担っています。

*下図はイメージであり、半導体製造工程のすべてを表したものではありません。

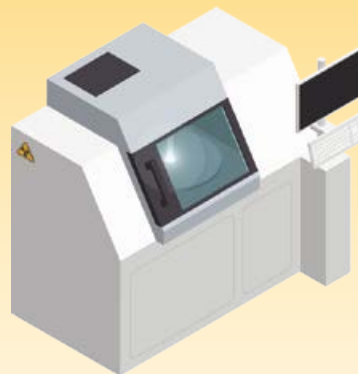
半導体製造工程のイメージ

1 設 計



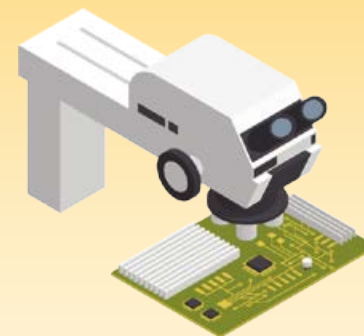
電子部品の配置と
機能を設計する

2 製 造



精密な工程で基盤に
回路を形成し、製造する

3 組 立



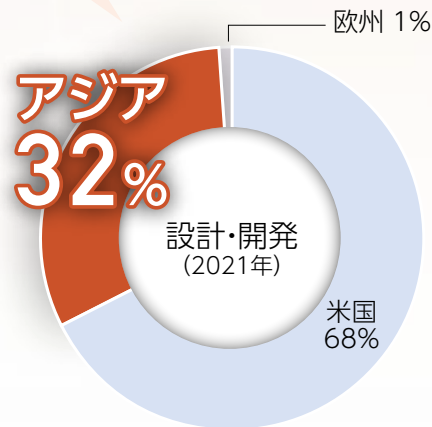
製造された部品を切り分けたり、
組立を行い製品にする

製造工程別の市場シェア（主要国・地域別）

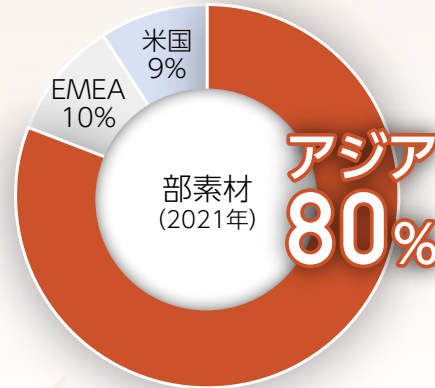
設計や開発 などに特化

<主な企業例>

- アルチップ・テクノロジーズ(台湾)
- メディアテック(台湾)



半導体の製造過程で使用する 材料や部品を供給



<主な企業例>

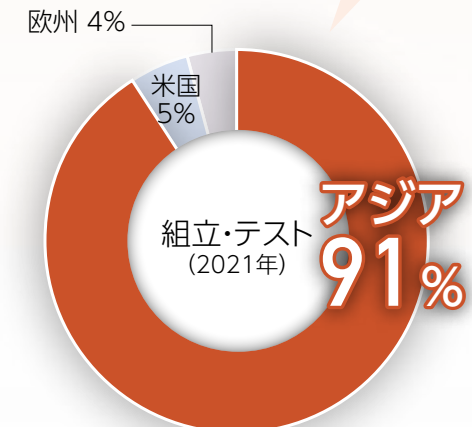
- 信越化学工業(日本)
- トリケミカル研究所(日本)

半導体の仕上げ工程となる

組立や検査 などに特化

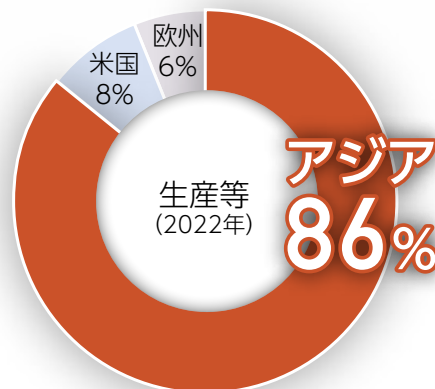
<主な企業例>

- ディスコ(日本)
- アドバンテスト(日本)



他社からの委託による

生産などに特化



<主な企業例>

- TSMC(台湾セミコンダクター)(台湾)
- SKハイニックス(韓国)

※上記各比率は、四捨五入しているため合計が100%とならない場合があります。
 ※アジア：日本、台湾、韓国、中国(生産等と組立・テストの比率は東南アジア含む)
 EMEA：欧州、中東、アフリカ
 ※主な企業例について、個別銘柄の推奨および当ファンドへの組入れを示唆・保証するものではありません。

(出所) ニューバーガー・バーマン、各社HP

市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

アジア各国で半導体への投資が拡大

アジアの各国・地域において、半導体産業への政策支援が加速しています。

さらに、大手半導体企業による旺盛な設備投資が行われるなど、半導体生産体制の強化によって需要が高まるアジアには、魅力的な投資機会があります。

アジア各国・地域の政策支援と半導体企業による主な投資事例（2025年2月末時点）

韓国

投資額

約35兆円



2022年に「半導体超強大国達成戦略」を発表。2026年までに、約35兆円以上（340兆ウォン以上）の投資をする方針。

投資事例

サムスン電子（韓国）とASML（オランダ）が約1,032億円（1兆ウォン）を投資し、韓国に超微細先端半導体工程技术を開発する研究施設を建設することを決定。

台湾

投資額

約10兆円



2023年に「台湾投資三大方案」を活用した台湾企業の投資金額は、累計で約10兆円（2.1兆台湾ドル）となる。

投資事例

ASML（オランダ）が台湾に、約1,373億円（300億台湾ドル）を投資し、2nmウェハー用光学測定装置の研究・開発及び、製造拠点を設ける大規模な計画を打ち出した。

日本

投資額

12兆円



「AI・半導体産業基盤強化フレーム」を策定し、2030年度までに10兆円以上の公的支援を行い、今後10年間で官民合わせて50兆円規模を投資する方針。

投資事例

TSMC（台湾セミコンダクター）（台湾）が熊本県に日本で初となる工場を建設。先端半導体を手がける第2工場の建設も決まり、投資総額は約3兆円（225億米ドル）の見通し。日本政府も最大1兆2,000億円あまりを補助する。

※それぞれ以下の為替レートで円換算

・韓国：1ウォン＝0.1032円

・日本：1米ドル＝150.63円

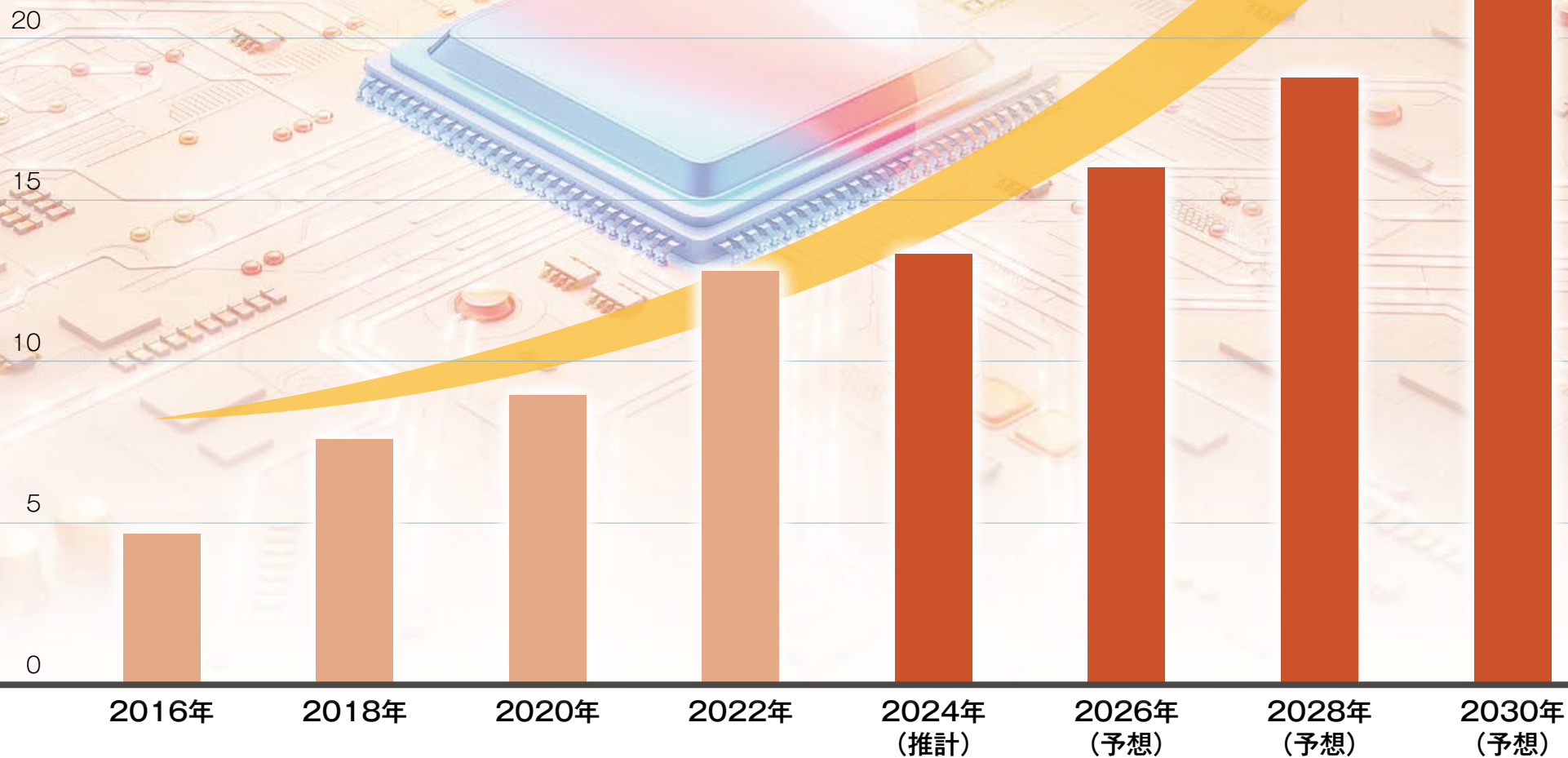
・台湾：1台湾ドル＝4.577円

※個別銘柄の推奨および当ファンドへの組入れを示唆・保証するものではありません。

（出所）経済産業省、各種資料、報道等、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

(兆円)
25
アジアの半導体製造装置の売上高推移(予想)

生産体制の強化により
さらなる成長期待!



※アジア：日本、台湾、韓国、中国 ※2024年以降は、ニューバーガー・バーマンによる2025年2月末時点の推計値および予想値(1米ドル=150.63円で円換算)

(出所) ニューバーガー・バーマン、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

深い知識と経験を有する運用チーム

アジア半導体セクターNo.1セルサイド・アナリスト

ベストアナリストランキング 4年連続1位

*アジアマネー誌によるベストアナリスト
ランキング(半導体・半導体製造装置)で
4年連続(2017年~2020年)1位に選出

- 前職では、CLSA証券にて
テクノロジー・リサーチ責任者として
約30名のチームを指揮
- 2019年~2020年には
Institutional Investors誌で
アジア地域の半導体アナリストの
トップ5に選出される



豊富な経験とネットワークを有する アジア半導体チーム



ヤン・ター(YT)ブーン 【香港】
大手半導体企業において
計9年間の半導体デザイナー経験



セバスチャン・ホウ 【台北】
アジア半導体セクター
No.1 セルサイド・アナリスト



杉本健斗 【日本】
日本半導体セクター
セルサイド・アナリスト経験



ウォーレン・シュウ 【台北】
半導体中心に豊富な
テクノロジーファンドの運用経験

1939年創業の独立系資産運用会社 ニューバーガー・バーマン

ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シー

- 1939年創業で、従業員によりすべての自社株式が保有される米国の独立系
資産運用会社です。世界の運用拠点にて**760名**の運用担当者が、世界中の
機関投資家や個人投資家向けに、様々な資産運用サービスを提供しています。
- 運用資産残高は**約5,077億米ドル(約80兆円)**、従業員数**約2,900名**を有し
ています。

※2024年12月末現在、1米ドル=157.16円で円換算

ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー

- ニューバーガー・バーマン・グループ・エル・エル・シーの100%子会社であり、
グループ内における株式、リート、債券、オルタナティブにかかわる運用部門
です。
- ニューヨークを拠点に世界各地のネットワークを駆使してグローバル株式
についての綿密なリサーチを実施し、機動的かつ効率的なポートフォリオ
運営を行っています。

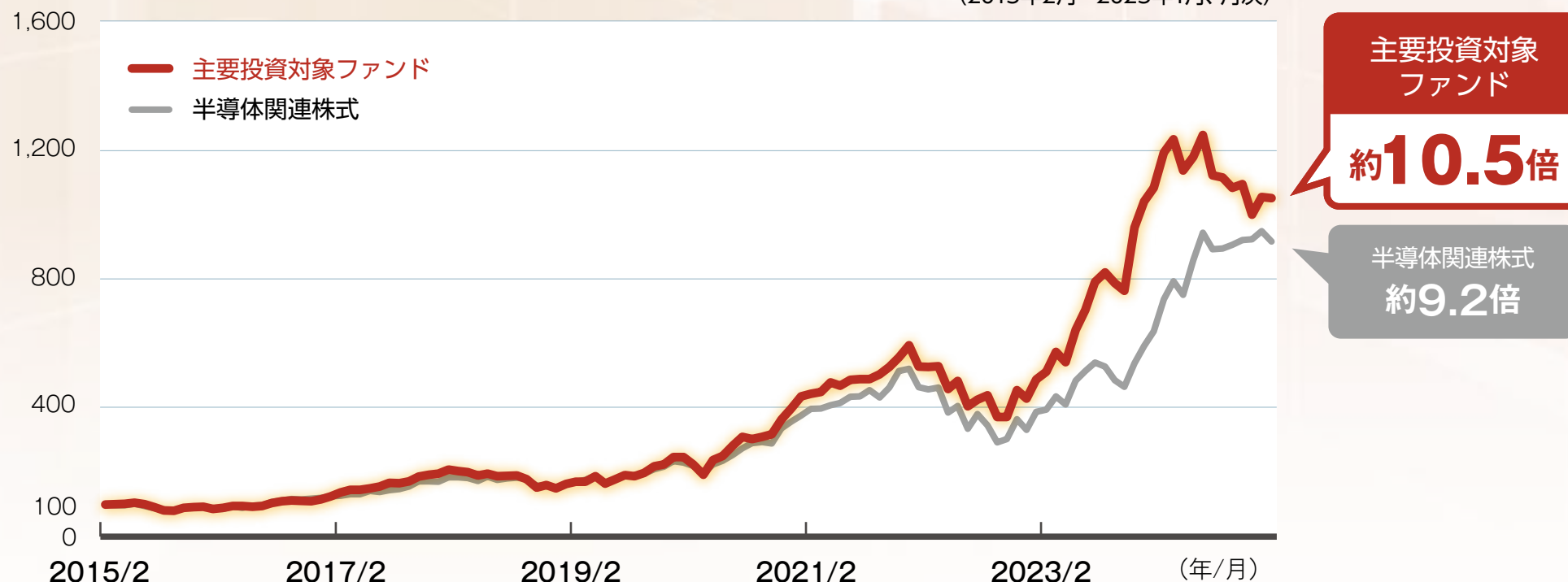
(出所)ニューバーガー・バーマン

潜在的な投資機会を捉える

ニューバーガー・バーマンは、アジアの半導体産業に精通した専門家集団による優れたリサーチ力で、イノベーション企業を発掘し、潜在的な投資機会を捉えることで優れたパフォーマンスを生み出します。

主要投資対象ファンドと半導体関連株式の推移

(2015年2月～2025年1月、月次)



※2015年2月末を100として指数化

※主要投資対象ファンド:Next Generation Semiconductor Asia Fund (円建て、ヘッジなしクラス) について、2024年7月末まではモデルポートフォリオ (米ドル建て、報酬控除前) のパフォーマンス、2024年8月以降は実際のポートフォリオのパフォーマンス (米ドル建て、報酬控除前) を基に算出

※半導体関連株式:MSCIオール・カントリー・ワールド・半導体・半導体製造装置インデックス (米ドル建て、配当込み)

MSCIオール・カントリー・ワールド・半導体・半導体製造装置インデックスは、MSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(出所) ニューバーガー・バーマン、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

上記は、主要投資対象ファンドの運用戦略をご理解いただくためにお示ししているもので、当ファンドの運用実績ではありません。

市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

アジア半導体関連企業のご紹介

ディスコ



日本

キーテクノロジー SiCダイシング装置、グラインダ装置

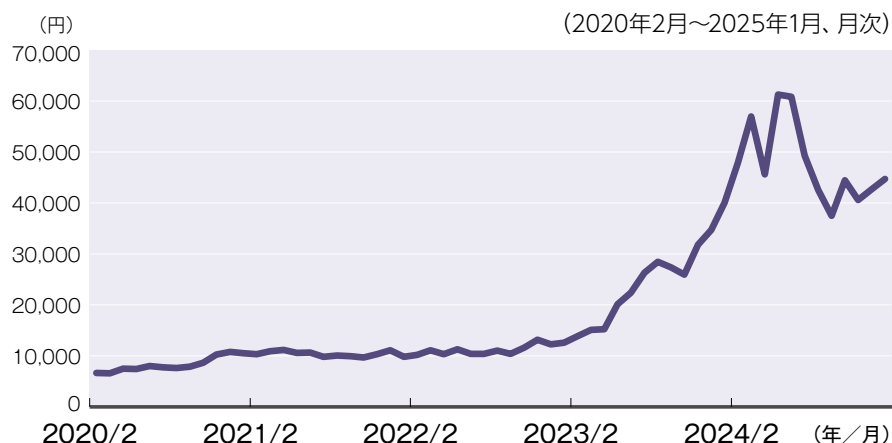
主な戦略的パートナー企業 TSMC、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ など

事業内容と着目ポイント

- 日本のダイシング・グラインダ装置メーカー。ダイシング工程で使われるダイシングソーでは、グローバルシェア約80%の世界トップメーカー。
- 同社は、硬質で加工に時間がかかるSiC（炭化ケイ素）向けに、レーザー加工によるスライス手法「KABRA」を開発。半導体生産大手TSMC（台湾セミコンダクター）、インテルと長期的なリレーションシップを有するほか、世界中に幅広い顧客リーチを有し、SiC市場の拡大から恩恵を受ける。



株価の推移



※写真はイメージです。※キーテクノロジーとは、競争優位性を発揮する技術のことをいいます。

TSMC (台湾セミコンダクター)



台湾

キーテクノロジー スマートフォン・AI/HPC向け半導体製造

主な戦略的パートナー企業 エヌビディア、アップル など

事業内容と着目ポイント

- 台湾の半導体受託製造専門企業。スマートフォンやAI/HPC（ハイ・パフォーマンス・コンピューティング）向けの最先端半導体の受託製造に強み。
- 同社は半導体の微細化において業界をリードし、線幅一桁nm（ナノメートル）の半導体を量産できる数少ない企業。最新iPhoneやAI向け半導体など、最先端のロジック半導体を独占的に供給。



株価の推移



(出所) ニューバーガー・バーマン、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

上記は当ファンドの主要投資対象ファンドにおける投資銘柄例の紹介を目的としたものであり、記載銘柄の推奨および個別銘柄の組入れを示唆または保証するものではありません。

市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

アジア半導体関連企業のご紹介

リノ・インダストリアル



キーテクノロジー 半導体テストピン&ソケット

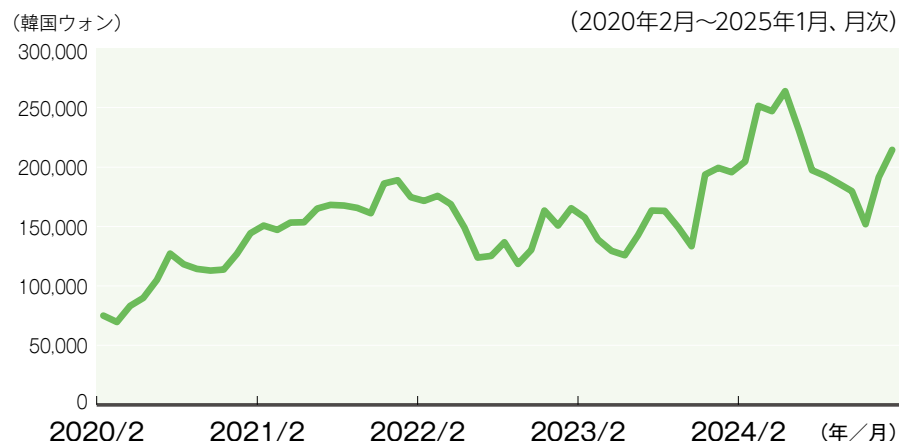
主な戦略的パートナー企業 クアルコム、アップル、サムスン電子、シーメンス など

事業内容と着目ポイント

- 韓国を拠点とする同社は、完成品チップの不具合を検出するために使用されるハイエンド半導体テストピン及びソケットを開発・供給する。
- 同社の製品は高度にカスタマイズされた特注品。業界をリードする高精度ピンにより、半導体業界の高まる複雑性に対応し、AR/VRデバイス向けチップ(クアルコムのSnapdragon)から、メタバース向けGPU(エヌビディアのオムニバース)まで開発をサポートしている。



株価の推移



※写真はイメージです。※キーテクノロジーとは、競争優位性を発揮する技術のことをいいます。

メディアテック

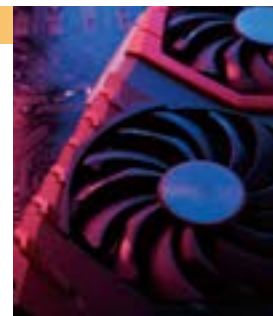


キーテクノロジー SOC(システム機能を搭載した集積回路)

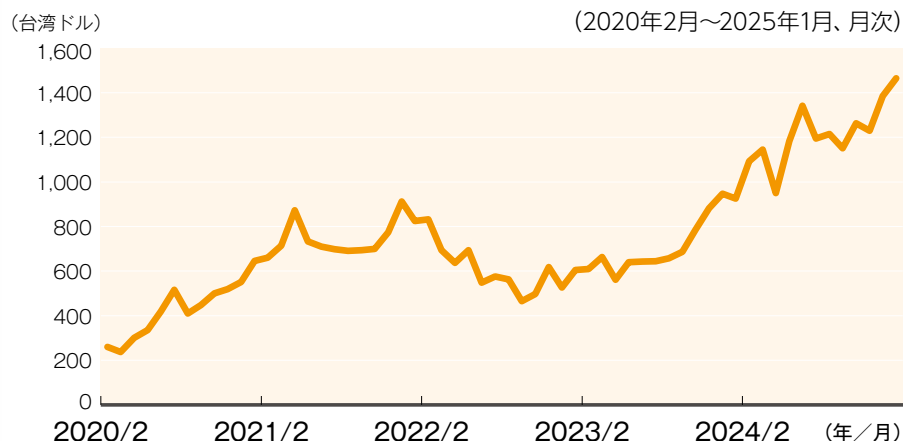
主な戦略的パートナー企業 エヌビディア、アルファベット、サムスン電子 など

事業内容と着目ポイント

- 半導体の設計を手掛けるファブレス企業(製造は他社に委託)。スマートフォンやIoT(モノのインターネット)機器向けにシステム機能を搭載した集積回路「SoC(システム・オン・チップ)」を展開しており、中国・韓国などのスマートフォンメーカーが主な顧客。
- 同社はAI(人工知能)半導体を手掛けるエヌビディアと協業しており、AI向けデスクトップPCを共同で開発。培ってきた半導体の設計力を武器にAI分野に進出するなど、今後も業績の拡大が続くと見込まれる。



株価の推移



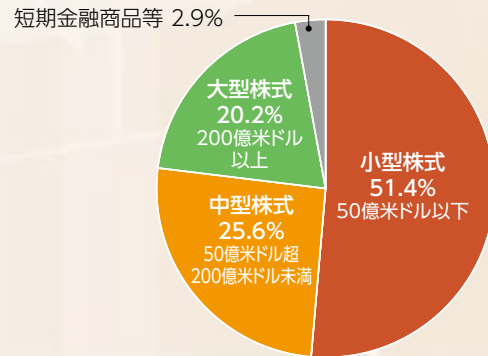
(出所) ニューバーガー・バーマン、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

上記は当ファンドの主要投資対象ファンドにおける投資銘柄例の紹介を目的としたものであり、記載銘柄の推奨および個別銘柄の組入れを示唆または保証するものではありません。

市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。

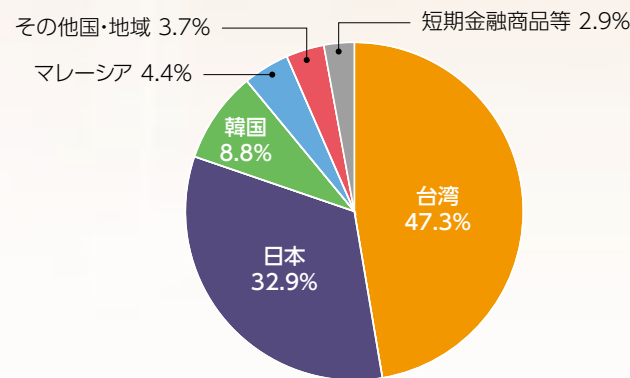
主要投資対象ファンドのポートフォリオ（2025年1月末時点）

企業規模（株式時価総額）別構成比率



※上記は本資料においての分類

国・地域別構成比率



※各構成比率は主要投資対象ファンドの純資産総額に対する比率です。
※四捨五入しているため、合計が100%とならない場合があります。

組入上位10銘柄（組入銘柄数：52銘柄）

企業名	国・地域	組入比率	企業概要
1 TSMC (台湾セミコンダクター)	台湾	4.8%	スマートフォンやデータセンター向け最先端半導体の受託製造に強み。
2 メディアテック	台湾	4.1%	スマートフォンやIoT機器など、幅広い用途向けにSoC (システム・オン・チップ)を提供。
3 SKハイニックス	韓国	4.1%	DRAM、NANDフラッシュメモリ、SRAMチップなどを製造。
4 eメモリー・テクノロジー	台湾	3.6%	半導体回路設計図を開発する半導体IP (知的財産)企業でセキュリティに関する設計に強みを持つ。
5 ASメディア・テクノロジー	台湾	3.6%	USBコントローラーなど高速インターフェース向けの半導体設計に強み。
6 荏原製作所	日本	3.6%	半導体製造の分野にむけて平坦化技術 (CMP装置) や真空技術 (真空ポンプ) を手掛ける。
7 グローバル・ユニチップ	台湾	3.6%	特定の機器や用途のために設計するASIC (カスタムIC) に強みを持つ。
8 ディスコ	日本	3.4%	「切る (ダイサ)」「削る (グラインダ)」「磨く (ポリッシャー)」という3つの加工技術に強み。
9 芝浦メカトロニクス	日本	3.3%	前工程装置から後工程装置まで幅広く展開し、特に高精度のダイボンダー装置に強み。
10 MARUWA	日本	3.1%	半導体分野で活用される製品を手掛ける。

※組入比率は主要投資対象ファンドの純資産総額に対する比率です。

(出所) ニューバーガー・バーマン

上記は当ファンドの主要投資対象ファンド「Next Generation Semiconductor Asia Fund (円建て、ヘッジなしクラス)」における2025年1月末時点のポートフォリオをご参考までに示したものであり、特定銘柄の投資を推奨しているものではありません。また、当該銘柄に投資することを示唆または保証するものではありません。

主要投資対象ファンドの運用プロセス

- 主要投資対象ファンド「Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)」の運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
- ポートフォリオマネージャーが、アナリストと緊密に連携しポートフォリオを構築し、徹底した議論に基づき、テーマとの適合性を検証します。

投資ユニバース

日本を含む世界の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業の株式

500銘柄以上

高成長領域の特定

「イノベーション」や「サイクル」を分析。高成長が期待できる領域を特定し関連銘柄を抽出

100~150銘柄

個別銘柄の詳細調査・バリュエーション分析

企業ファンダメンタルズ分析(財務データ分析、企業経営陣との面談、技術動向調査等)
成長性と株価バリュエーションを検証し、割安な銘柄を選定

ポートフォリオ構築

地域・業種分散に配慮し、リスク調整後リターンの最大化を追求

35~65銘柄

※上記運用プロセスおよび銘柄数は、今後変更になる場合があります。

(出所)ニューバーガー・バーマン

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

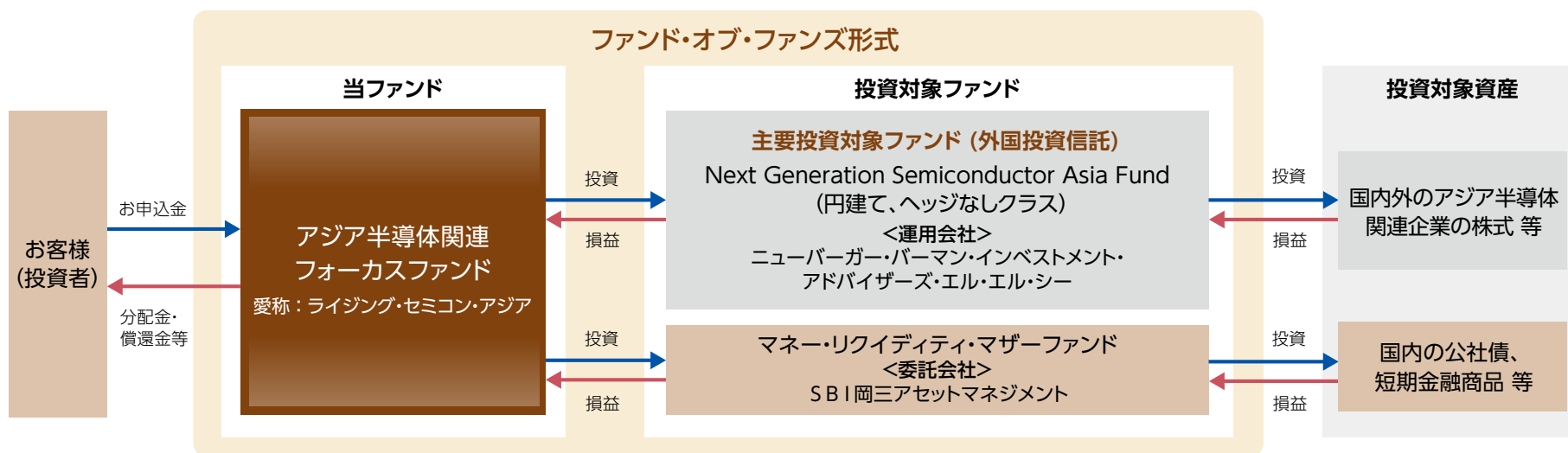
ファンドの特色



アジアの半導体関連企業*の株式に実質的に投資します。

●投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業*の株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。

* アジア半導体関連企業とは
半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業をいいます。



●Next Generation Semiconductor Asia Fund(円建て、ヘッジなしクラス)の組入比率は、高位を保つことを基本とします。



ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定します。



実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

投資リスク

基準価額の変動要因

投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。
ファンドは、国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

■主な変動要因

株価変動リスク	株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。
為替変動リスク	外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。
特定の業種・テーマへの集中投資に係るリスク	ファンドは、特定の業種・テーマに関連する企業の株式を組み入れます。そのため、市場全体の値動きと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
信用リスク	有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となることがあります。
流動性リスク	有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況の急変、取引所の閉鎖等により、有価証券等の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることがあります。

■その他の変動要因 カントリーリスク

※「基準価額の変動要因」は、上記のリスクに限定されるものではありません。

留意事項

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。
- 投資対象とする投資信託証券にかかる購入・換金申込みの受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込みの受付を取消することがあります。

お申込みメモ

購 入 時	購 入 単 位	販売会社が定める単位 ◆詳しくは販売会社にご確認ください。
	購 入 価 額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 時	換 金 単 位	販売会社が定める単位 ◆詳しくは販売会社にご確認ください。
	換 金 価 額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
	換 金 代 金	換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
そ の 他	購 入・換 金 申 込 不 可 日	以下に該当する日は、購入・換金申込みの受付を行いません。 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ニューヨークもしくは香港の取引所の休業日
	信 託 期 間	2045年7月14日まで(2024年7月17日設定) ◆投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。
	決 算 日	1月および7月の各月17日(休業日の場合は翌営業日)
	収 益 分 配	年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ◆将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
	課 税 関 係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。 ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お客様にご負担いただく費用

お客様が直接的に負担する費用

購入時	購入時手数料	購入金額(購入価額×購入口数)×上限3.3%(税抜3.0%) ◆詳しくは販売会社にご確認ください。 ◇ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。
換金時	換金手数料	ありません。
	信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%

お客様が信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中	運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額×年率1.2925%(税抜1.175%)		
		委託会社	年率0.35%(税抜)	◇委託した資金の運用の対価です。
		販売会社	年率0.80%(税抜)	◇運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
		受託会社	年率0.025%(税抜)	◇運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
保有期間中	運用管理費用 (信託報酬)の 実質的な負担	純資産総額×年率1.9425%程度 実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。 なお、実質的な運用管理費用(信託報酬)は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。		
	その他費用・ 手数料	監査費用：純資産総額×年率0.0132%(税抜0.012%) 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を投資信託財産でご負担いただきます。 また、投資対象とする投資信託証券に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用等を間接的にご負担いただきます。 (監査費用を除くその他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)		

○お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

○詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご参照ください。

委託会社およびその他の関係法人

委託会社 [投資信託財産の設定、運用の指図等]	SBI岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 [投資信託財産の保管・管理等]	三井住友信託銀行株式会社
販売会社 [購入・換金の取扱い等]	販売会社の詳細につきましては、右記の委託会社電話番号までお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。

委託会社お問合わせ先

電話番号

03-3516-1300
(営業日の9:00~17:00)

ホームページ

<https://www.sbiokasan-am.co.jp>

■本資料は、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。本資料中の図表等は、各出所先(ホームページを含む)のデータを基にSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものです。記載内容、数値、図表等は、本資料作成日時点のものであり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものではありません。本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

■購入の申込みに当たっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「契約締結前交付書面」又は「目論見書補完書面」を十分にお読みいただき、投資判断は、お客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

